

# 5-103916-1 ! 试产

AMPMODU | AMPMODU System 50

TE 内部编号 5-103916-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 1.27 mm

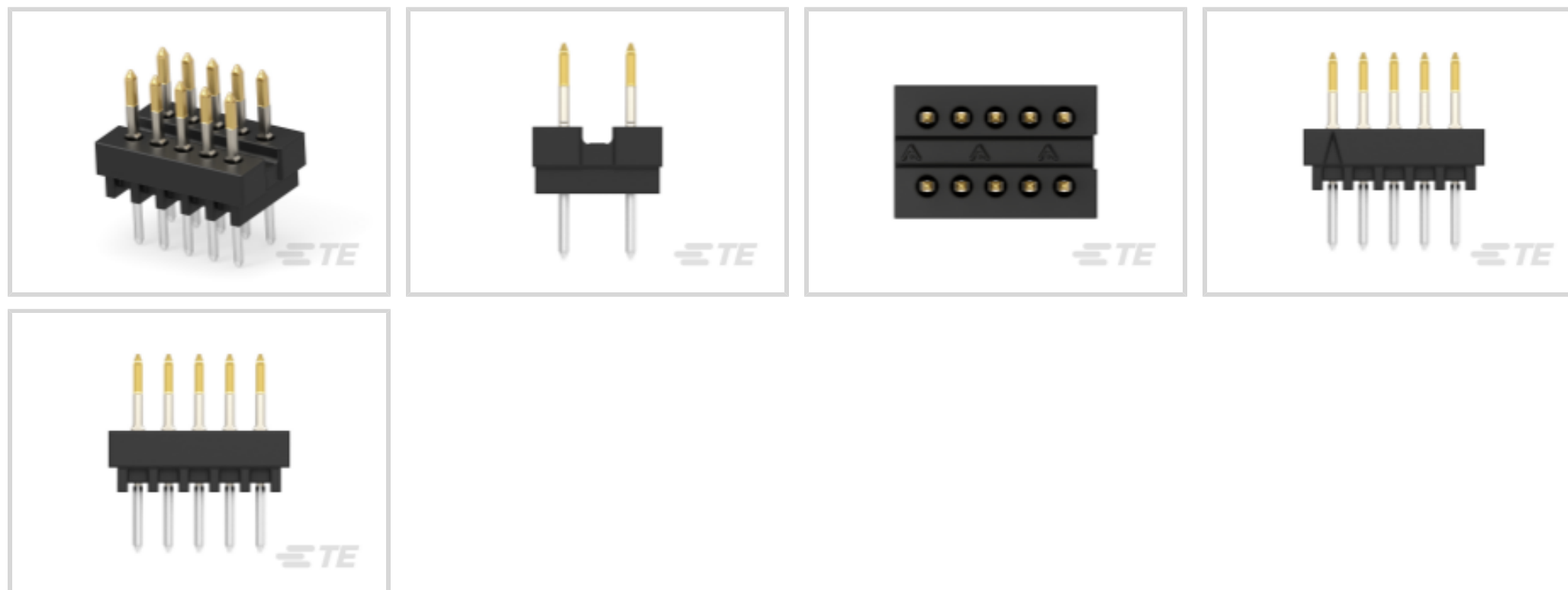
[.05 in] Centerline, Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder,

AMPMODU System 50

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 2

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

板对板配置	平行
连接器端子负载状态	满载
位数	10
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	500 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

工作电压	30 VAC
------	--------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
--------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 $\mu$ m[150 $\mu$ in]
------------------	-----------------------------------

端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu$ m[30 $\mu$ in]
--------------	--------------------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	矩形
---------	----

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	3.6 A
-------------	-------

### 端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.38 mm[.015 in]
-------------	-----------------

端接柱体和尾部长度	2.54 mm[.1 in]
-----------	----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	不带
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

### 壳体特性

外壳材料	LCP
------	-----

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

### 尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

### 使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工作温度范围

-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

### 操作/应用

电路应用

Signal

### 行业标准

UL 等级

获得认可

与机构/标准产品兼容

CSA, UL

与已批准的标准产品兼容

CSA LR7189, UL E28476

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装数量

100

封装方法

Box, Tube

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



## 客户还购买了





## 文档

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103916-1\\_V.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103916-1\\_V.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103916-1\\_V.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

产品规格

英文版本